

กมลชนก เมฆหมอก : การศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Local back passivation จาก
ลวดลายของฟิล์ม Borosilicate glass ด้วยสารละลายโบรอน (STUDY OF LOCAL BACK
PASSIVATION SOLAR CELL STRUCTURE USING PATTERNS OF BOROSILI-
CATE GLASS FILM BY BORON SOLUTION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิพย์วรรณ พิงสุวรรณรักษ์, 136 หน้า.

โครงสร้างด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนรอยต่อ p/n-Si มีส่วนประกอบของชั้น
ฟิล์มบางไดออกไซด์ทริกที่มีลวดลายช่องเปิดขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดบริเวณพาหะที่ผิวสัมผัสที่แผ่น
ฐานซิลิคอนด้านหลัง เรียกว่า Local back passivation หรือ Local back surface field (LBSF) บริเวณ
นี้ยังเกิดสนามไฟฟ้าภายในชั้น ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลให้การรวมตัวใหม่ของพาหะที่
บริเวณด้านหลังลดลง ในปัจจุบันการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ในอุตสาหกรรมนิยม
ใช้วิธีที่ใช้พลังงานสูง เช่น เลเซอร์ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเซลล์เกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงได้ทำการศึกษาการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนโครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีต้นทุนต่ำจากการ
สร้างลวดลายช่องเปิดขนาดเล็กจากฟิล์มบางไดออกไซด์ทริกด้วยวิธีการประทับลาย ซึ่งเป็นหลักการ
สกัดผิวด้วยสารละลายเคมี ทำให้ไม่เกิดความเสียหายที่รอยสัมผัสซิลิคอน

งานวิจัยนี้ได้สร้างบริเวณ p⁺-Si ด้านหลังบางบริเวณด้วยการใช้สารละลายโบรอนที่มี
เปอร์เซ็นต์อะตอมของโบรอนเท่ากับ 0.15% โดยผ่านวิธีการประทับลายและแพร่สารเจือที่อุณหภูมิ
1150°C เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดบริเวณ p⁺-Si ที่เหมาะสมโดยมีความต้านทานไฟฟ้าแผ่น
ประมาณ 46 Ω/sheet นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการสังเคราะห์ฟิล์มบางไดออกไซด์ทริกชนิดต่าง ๆ ได้แก่
ฟิล์มฟอสโฟซิลิเกต (Phosphosilicate glass, PSG) และฟิล์มโบโรซิลิเกต (Borosilicate glass, BSG)
จากกระบวนการแพร่สารเจือด้วยความร้อน ฟิล์มซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO₂) จากกระบวนการ Dry
oxidation และฟิล์มซิลิคอนไนไตรด์ (Si₃N₄) จากกระบวนการ Sputtering และ Plasma enhanced
chemical vapor deposition (PECVD) เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเป็นชั้นพาหะในเซลล์
แสงอาทิตย์ซิลิคอนโครงสร้าง LBSF

โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบที่ได้พิจารณาในการศึกษานี้ แบ่งได้เป็น 2 โครงสร้าง
คือ เซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ที่มีบริเวณช่องเปิดชั้นฟิล์ม BSG เป็นชั้นไดออกไซด์ทริก
ด้านหลัง โดยเซลล์ในโครงสร้างมีความต้านทานไฟฟ้าแผ่นด้านรับแสงในช่วง 110 - 130 Ω/sheet
โครงสร้างนี้ให้ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงที่สุด คือ 5.30% ในเงื่อนไขที่มีสัดส่วนพื้นที่
ช่องเปิดของชั้นฟิล์ม BSG ที่ 15% และเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ที่มีบริเวณ p⁺-Si โดย
การศึกษานี้ได้ใช้บริเวณช่องเปิดชั้นฟิล์ม Si₃N₄ เป็นชั้นไดออกไซด์ทริกด้านหลัง โครงสร้างนี้ให้ค่า
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงที่สุด คือ 8.76% ในเงื่อนไขที่มีสัดส่วนพื้นที่ช่องเปิดของชั้น

ฟิล์ม Si_3N_4 ที่ 15% อีกทั้งเมื่อนำเงื่อนไขที่ดีที่สุดมาจำลองด้วยโปรแกรม PC1D จากผลการจำลองพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบโครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีการประทับลายให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างมาตรฐานกว่า 1.43% และเมื่อนำมาคำนวณความคุ้มค่าทุนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม พบว่าราคาต้นทุนต่อวัตต์ลดลงมากกว่า 3.71% เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างมาตรฐาน ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF จากผลลดาของฟิล์มบางไดโอดีกริกจากวิธีการประทับลาย จึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้



สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2562

ลายมือชื่อนักศึกษา กมลชนก
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ. น. น. น.

KAMONCHANOK MEKMORK : STUDY OF LOCAL BACK
PASSIVATION SOLAR CELL STRUCTURE USING PATTERNS OF
BOROSILICATE GLASS FILM BY BORON SOLUTION. THESIS
ADVISOR : ASST. PROF. THIPWAN FANGSUWANNARAK, Ph.D.,
136 PP.

LOCALBACK PASSIVATION SOLAR CELL/DOPANT SOLUTION
DIELECTRIC FILM/STAMPING

The rear structure of p/n junction silicon solar cell consists of a thin dielectric layer with its opening pattern. This will lead to perform in the surface passivation at the rear called as local back passivation or local back surface field (LBSF). The LBSF area also behaves as an internal electric field. This behavior results in a lower carrier recombination at the rear cell. Nowadays, many industrial fabrication techniques for LBSF solar cells are using high-power methods such as laser ablation. This will cause the cell surface to become easily damaged. Therefore, this research has been studied for the preparation of LBSF silicon solar cell structure with a low-cost method by using pattern-stamped approach to form a small opening pattern of a thin dielectric film. This chemical etching concept is able to avoid the silicon surface damage.

In this research, the pattern area of heavily dopant p^+ -Si on the local rear areas was demonstrated with using 0.15 at% through the stamping method and subsequent thermal diffusion at 1150°C for 30 minutes. The appropriate p^+ -Si localized arear obtains the sheet resistance at 46 Ω /sheet. Furthermore, the synthesis of various types of dielectric film, including phosphosilicate glass (PSG), borosilicate glass (BSG),

